

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FS 300 R 17 KE3

eupec

vorläufige Daten
preliminary data

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1.700	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	300 375	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	600	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Transistor	P_{tot}	1660	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	300	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	600	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	16.800	A ² s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	3,4	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 300\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 300\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	- -	2,0 2,4	2,45 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 12\text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	5,2	5,8	6,4	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$	Q_G	-	3,4	-	μC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	25	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{res}	-	0,9	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1700\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 1700\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I_{CES}	- -	- -	5 -	mA mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Regine Mallwitz

date of publication: 1.3.2002

approved by: Christoph Lübke;2002-03-08

revision: 1

vorläufige Daten
preliminary data

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

min. typ. max.

Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,on}$	-	250	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 900V$	t_r	-	75	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 900V$	$t_{d,off}$	-	820	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 300A, V_{CE} = 900V$	t_f	-	100	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 300A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$	E_{on}	-	120	-	mWs
	$R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 80nH$					
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 300A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$	E_{off}	-	100	-	mWs
	$R_G = 4,7\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 80nH$					
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$	I_{SC}	-	1110	-	A
	$T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 1000V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$					
Modulinduktivität stray inductance module		L_{sCE}	-	20	-	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	pro Zweig / per arm	R_{CC+EE}	-	1,1	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

min. typ. max.

Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	V_F	-	1,8	2,2	V
	$I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 300A, -di_F/dt = 3500A/\mu sec$	I_{RM}	-	370	-	A
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 300A, -di_F/dt = 3500A/\mu sec$	Q_r	-	80	-	μAs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 300A, -di_F/dt = 3500A/\mu sec$	E_{rec}	-	40	-	mWs
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$					

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FS 300 R17 KE3

eupec

**vorläufige Daten
preliminary data**

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,075	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,13	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,005	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation			Al2O3		
Kriechstrecke creepage distance			14		mm
Luftstrecke clearance			10		mm
CTI comperative tracking index			225		
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M5	3	-	6 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M6	M6	3	-	6 Nm
Gewicht weight		G	916		g

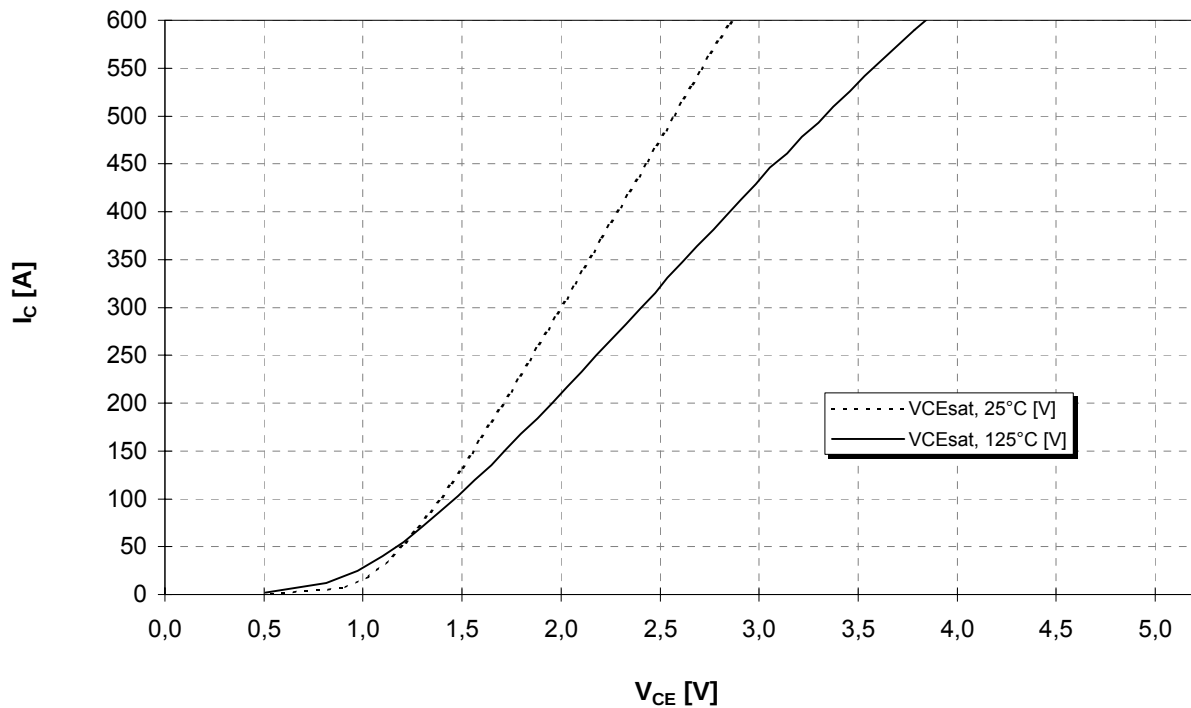
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is
valid in combination with the belonging technical notes.

Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$V_{GE} = 15V$

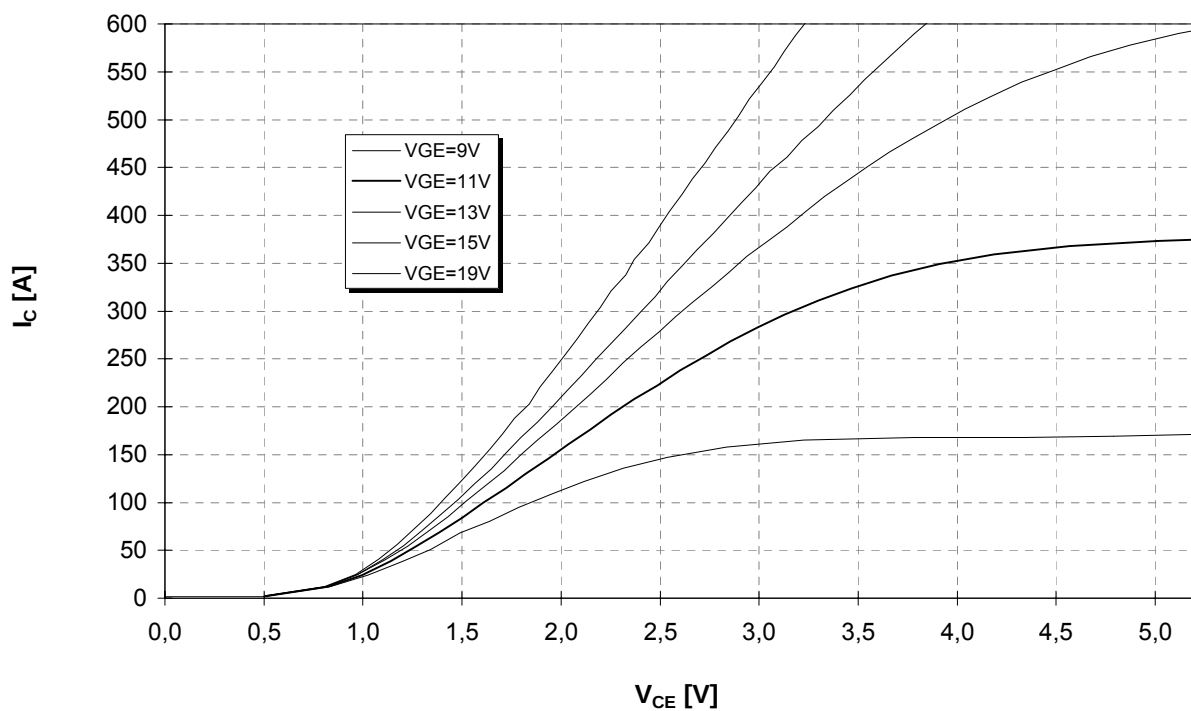
vorläufige Daten
preliminary data



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

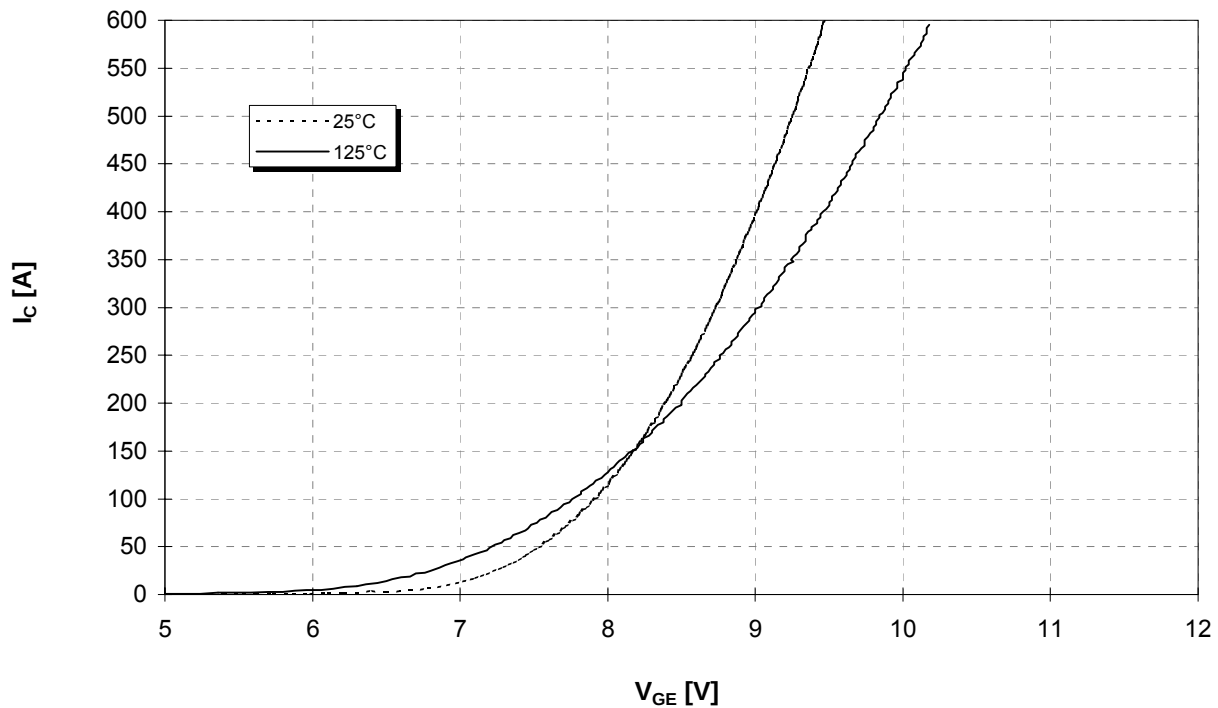
$T_{vj} = 125^\circ C$



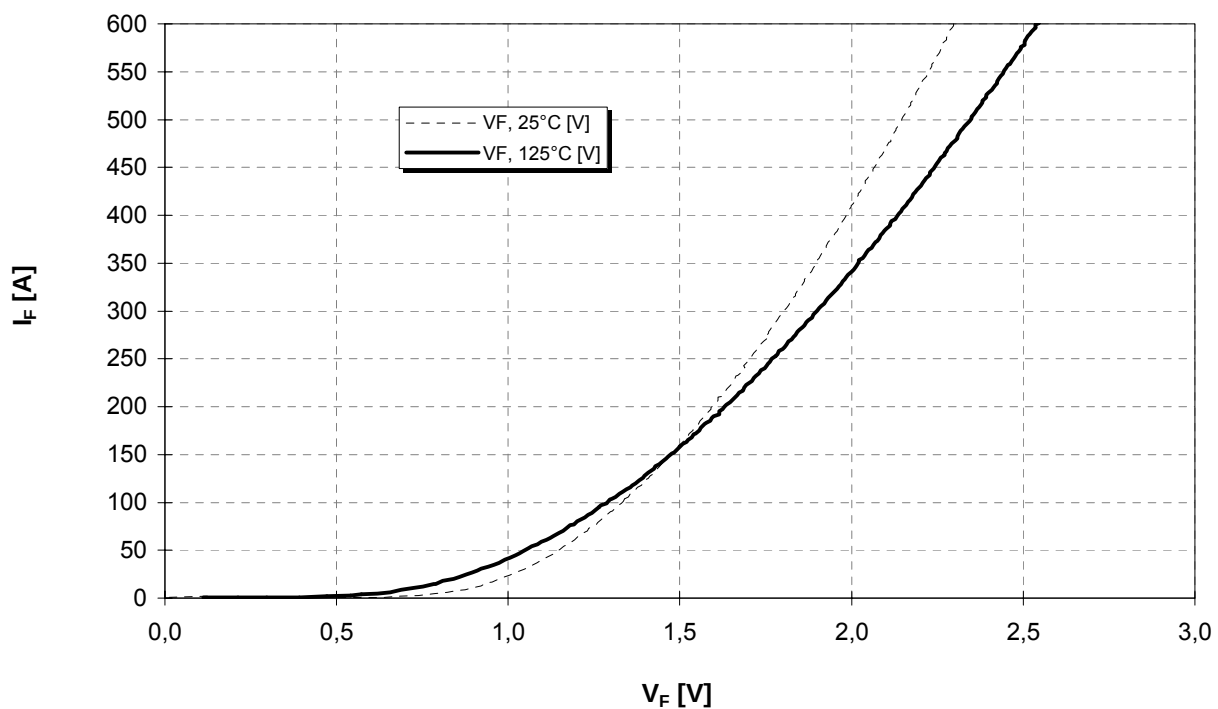
vorläufige Daten
preliminary dataÜbertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{GE})$$

$$V_{CE} = 20V$$

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

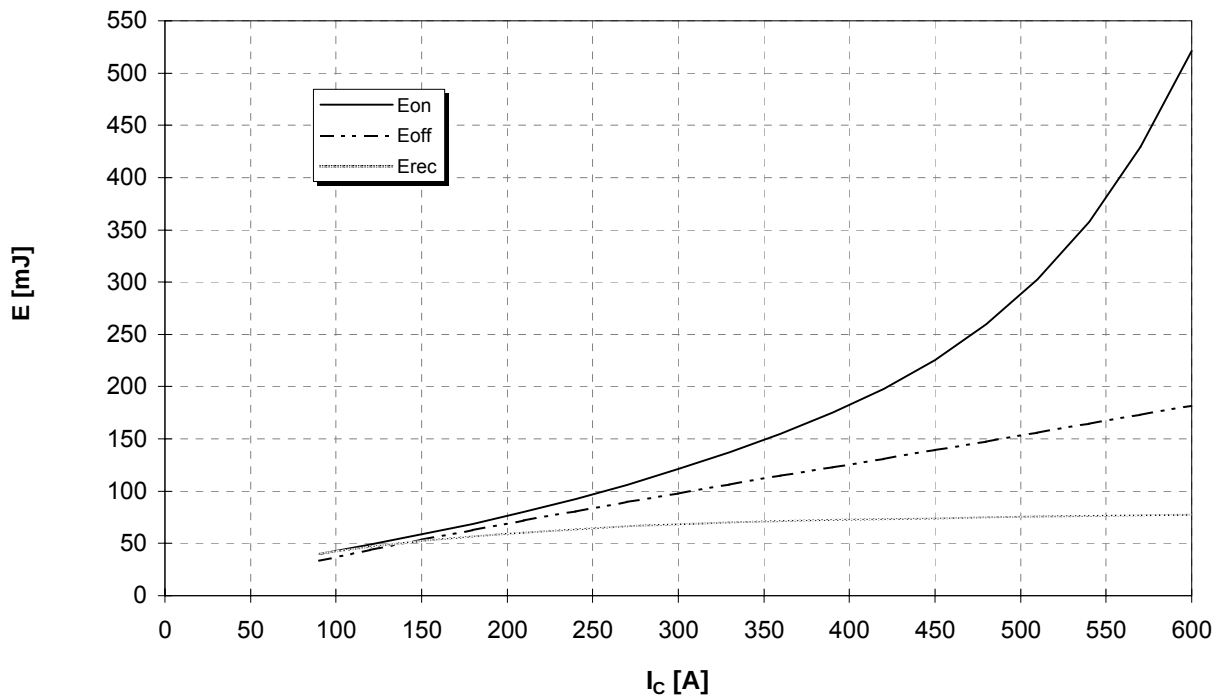


vorläufige Daten
preliminary data

Schaltverluste (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$

Switching losses (typical)

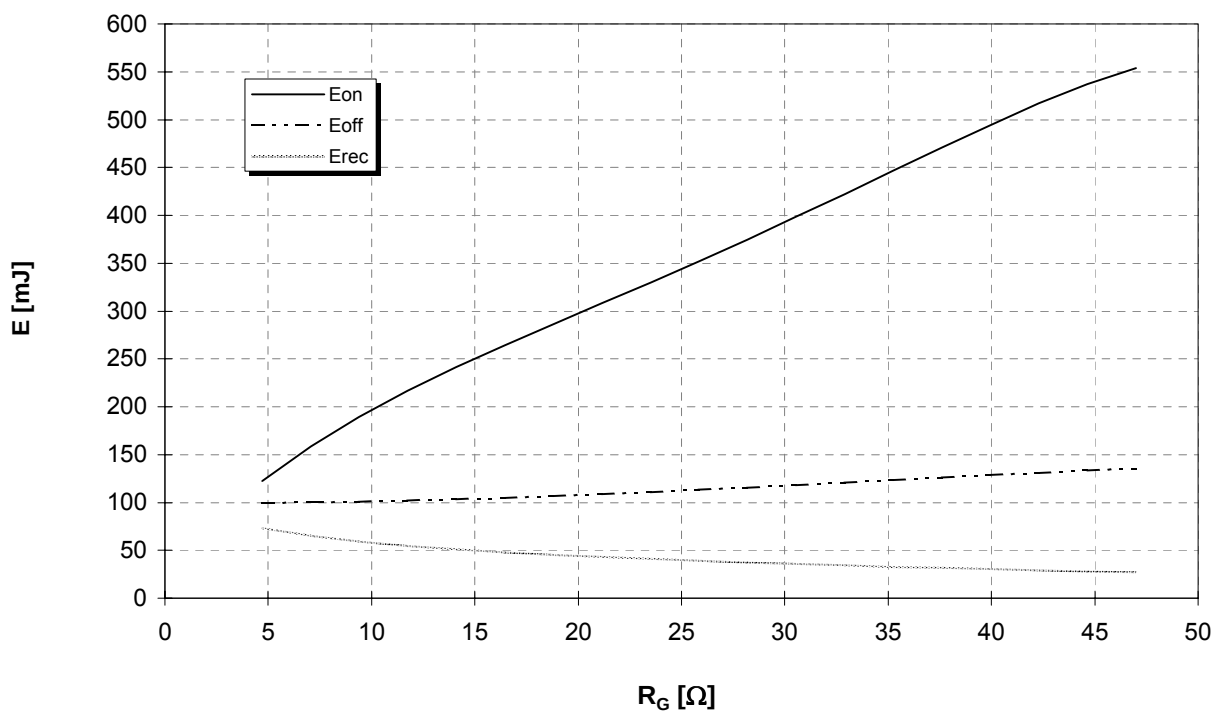
$R_{gon} = R_{goff} = 4,7 \Omega$, $V_{CE} = 900V$, $T_j = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

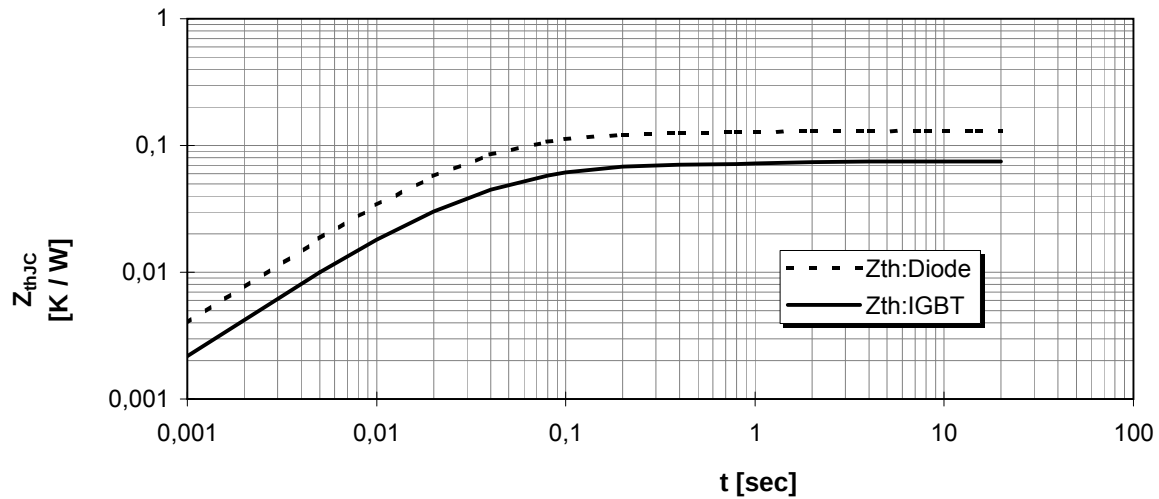
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$

$I_C = 300A$, $V_{CE} = 900V$, $T_j = 125^\circ C$



vorläufige Daten
preliminary dataTransienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t)$$



i		1	2	3	4
r_i [K/kW]	: IGBT	19,09	28,21	21,78	5,924
τ_i [sec]	: IGBT	0,01565	0,03977	0,07521	1,443
r_i [K/kW]	: Diode	44,06	48,89	30,96	6,1
τ_i [sec]	: Diode	0,02103	0,03011	0,08672	1,1583

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$R_g = 4,7 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$$

